

лак SOLDERLAC

Описание:

Прозрачное защитное покрытие и флюс для печатных плат SOLDERLAC разработан специально для защиты от окисления контактных площадок на только что изготовленных печатных платах и для выполнения аккуратной и надежной пайки. Его составляющие обеспечивают долговременную защиту от окисления, а также быструю пайку, предотвращая появление некачественных паяных соединений. SOLDERLAC, благодаря своей хорошей теплопроводности, заметно снижает риск перегрева печатной платы и ее компонентов. SOLDERLAC восстанавливает способность к спаиванию (смачиваемость припоем) у ржавых металлических поверхностей.

Применение:

Обеспечивает быструю, надежную и точную пайку любого рода. Особенно удобен для пайки чувствительных компонентов на печатных платах. Восстанавливает способность к паяному соединению окислившихся поверхностей. Эффективная защита от окисления контактных площадок на печатных платах, предназначенных для последующей пайки. Соответствует стандарту DIN 8511 FSW 31.

Технические характеристики:

Цвет: желтоватый

Плотность: 0,83 г/см³

Время высыхания: 20-30 мин

Температура размягчения: 80-85°C

Объем: 200 мл.

